

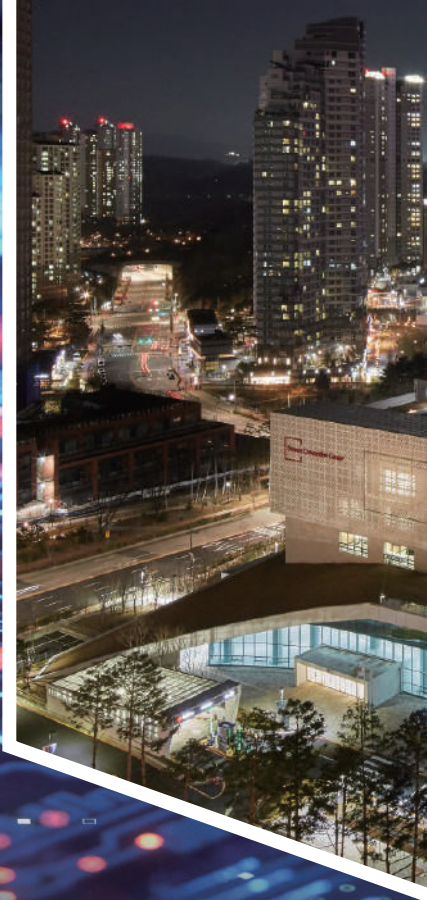
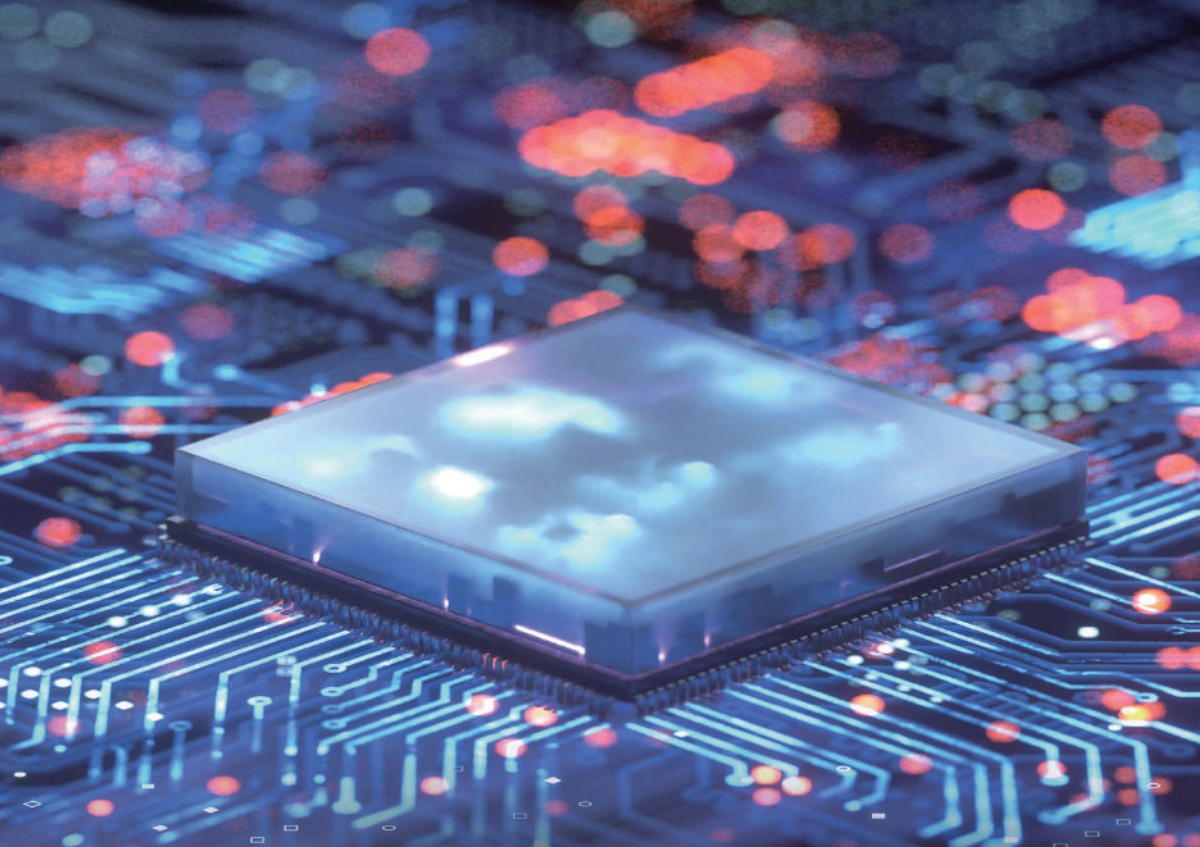
ASPS

2023

Advanced
SEMICONDUCTOR
PACKAGING
Show

차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전

2023 8.30(Wed) - 9.1(Fri)
Suwon Convention Center



Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show

Why 반도체 패키징?

최근 글로벌 반도체 수급난 가열과 함께 반도체 관련 제품의 성능 향상으로 인하여, 반도체 후공정 및 패키징 공정의 중요성이 나날이 대두되고 있습니다.

아직 반도체 패키징 산업은 초기 단계에 있으며, 최첨단 반도체 패키징 기술의 선제 도입은 미래 글로벌 시장 주도권 경쟁에 중요한 화두가 될 것입니다.


이에 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전(ASPS)은 최신 반도체 패키징 글로벌 트렌드 및 응용 장비, 재료, 기술 솔루션을 선보일 수 있는 국내 유일 반도체 후공정 전문 전시회로, 반도체 관련 최적의 입지조건을 갖추고 있는 수원컨벤션센터에서 2023년 8월 30일부터 9월 1일까지 개최합니다.


반도체 패키징 산업의 미래와 함께할 귀사를 본 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전에 초대하오니, 많은 참가 바랍니다.





Why 수원컨벤션센터?


화성, 용인, 평택, 오산, 이천, 성남, 수원, 안성
경기 남부 '스마트 반도체 도시 연합' 결성!


수원 
118만 4,404명
지역균형뉴딜 공모사업 및
예산지원 방식 개선


성남 
93만 1,072명
인공지능 반도체 팹리스
혁신성장 지원


화성 
88만 7,910명
화성 반도체 클러스터
조성 예정

용인 
107만 6,830명
용인 반도체클러스터
상반기 착공 예정

오산 
22만 9,973명
문암동 시스마르시티
조성 예정

이천 
22만 2,997명
SK하이닉스 M16 반도체
공장 본격 가동

평택 
56만 5,827명
세계 최대 반도체 공장
평택캠퍼스 확충 예정

안성 
18만 9,510명
반도체 관련 학과 정원 확대



Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show

전시회 개요

명칭	2023 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전 Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show 2023
약칭	ASPS 2023
기간	2023년 8월 30일(수) - 9월 1일(금)
시간	10:00 - 17:00 (금요일 16:30)
장소	수원컨벤션센터
규모	100개사, 520부스, 관람객 10,000명 (예상)
주관	(주)제이엑스포, (재)수원컨벤션센터, 전자신문
부대행사	차세대 반도체 패키징 컨퍼런스 참가업체 기술세미나 반도체 패키징 심포지움

The logo for ASPS (Asia Semiconductor Packaging Show) is displayed in a stylized, blue, 3D font. It is set against a dark blue background with faint, glowing circuit patterns and a network of nodes connected by lines. The logo is positioned in the upper left quadrant of the page, partially overlapping a blurred image of people in a modern building.

참가업체 전시 품목

- 반도체 패키징 검사 장비
- 반도체 패키징 어셈블리 장비
- 반도체 패키징 본딩 장비
- 반도체 패키징 테스트 장비 및 솔루션
- 반도체 패키징 부품 및 재료
- 반도체 패키징 코팅 장비
- 반도체 패키징 절단/접착/세척/드릴링 장비
- 반도체 PCB
- 반도체 후공정 장비 및 소재



관람객 프로필

- OSAT사
- 반도체 제조사
- 반도체 제조 협력사
- 유관 연구기관

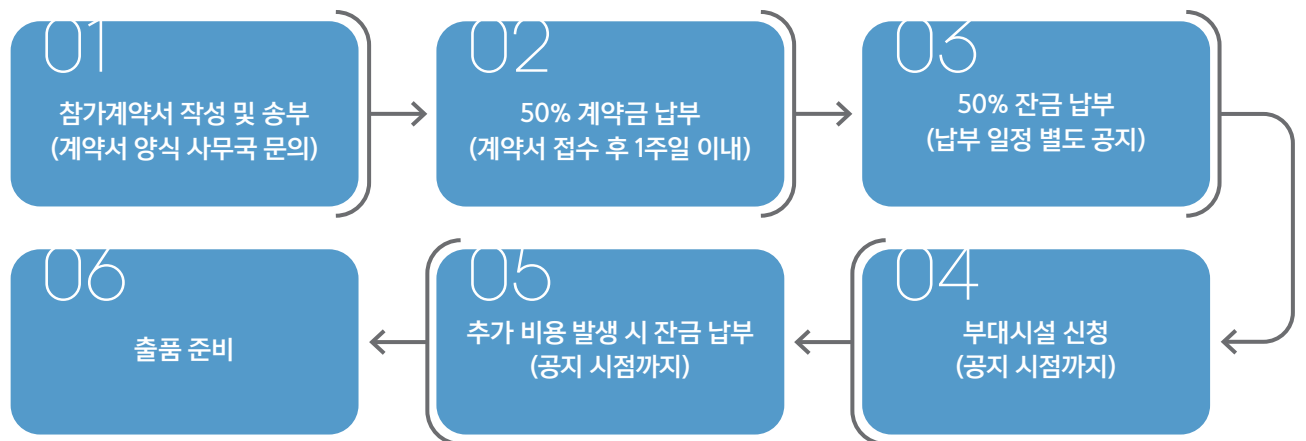
부대행사

- 차세대 반도체 패키징 컨퍼런스
- 참가업체 기술세미나
- 반도체 패키징 심포지움

Let's build
the future of
flexibility.

Embrace
change

참가 절차



참가비 안내



독립 부스

- 전시 면적만 제공
- 공식 시공사 섭외 필수
- 최소 신청 단위 = 2부스
- 참가비 252만원 / 부스



기본 부스

- 베이직 조립 타입 부스
- 기본 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 1부스
- 참가비 297만원 / 부스



프리미엄 부스

- 프리미엄 블록 타입 부스
- 프리미엄 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 2부스
- 참가비 402만원 / 부스

※ 1부스 = 9sqm



Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show

참가 문의처 | Contact

(주)제이엑스포 | J. Expo Ltd.

T. 02-6285-9131

E. semipkgshow@jexpo.or.kr